NEFAB expone en la Cumbre Industrial y Tecnológica de Bilbao

Nefab, compañía internacional especializada en Soluciones Completas de Embalaje para productos industriales, participarà activamente en la próxima edición de la Cumbre Industrial y Tecnológica de Bilbao, que se celebra entre el 27 y 30 de Septiembre.

La compañía expondrá sus soluciones de <u>embalaje</u> en un stand localizado dentro de la Cumbre, concretamente en la Feria Internacional de Subcontratación y Cooperación Empresarial. La muestra tendrá lugar en las instalaciones feriales con las que cuenta el Bilbao Exhibition Centre en Ansio-Barakaldo, y <u>Nefab</u> estará ubicada en el Pabellón 3, Stand D-55.

Nefab mostrará en su expositor, además de las Soluciones Completas de Embalaje para la industria, algunos de sus productos más representativos. Por una parte estará PadPak, un innovador sistema de inmovilización interior con pads de papel tipo 'kraft' reciclable, sin colas ni grapas y de muy fácil manejo. También mostrará sus reconocidos embalajes de tablero contrachapado Expak, un sistema de embalaje de exportación plegable, con perfiles de acero y ampliamente utilizado por industrias de todo tipo. Por último, también estará presente en el stand de Nefab sus sistemas de embalaje con protección anticorrosión (VCI), muy útiles para industrias como las de automoción. Concretamente los expertos de Nefab mostrarán su producto Excor, consistente en bolsas, funda y películas para embalaje que incorporan un polímero de materia VCI.

La Cumbre Industrial y Tecnológica-Feria Internacional de Maquinaria y Tecnologías para la Fabricación se ha convertido en los últimos años en un encuentro para todos los sectores afines a la fabricación. Se espera la presencia en la misma de más de 778 expositores de países de todo el mundo.

Datos de contacto Nuria García 916843342 nuria.garcia@nefab.es

Fuente: NEFAB